**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京盛芯科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **29.09.02;34.05.00** |
| **教师姓名** | 李京田 | **专业** | **29.09.02;34.05.00** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | 朱晓丽 |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 半导体芯片及电子元器件的设计开发：总体规划-版图提取-电路整理-工艺选择-版图绘制-电路仿真-制定测试规范-CP测试开发-流片-COB测试销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 设计开发过程为关键过程：设计开发控制程序、人员专业能力、设备能力、设计开发策划、设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认、设计开发变更等，均为设计开发关键过程，需对每个过程进行记录销售过程为特殊过程：销售主要质量指标：熟悉行业规范、具备执业素养、具有亲和力与良好的沟通能 力，了解顾客对公司的需求情况及顾客明示或隐含的要求  |
| **重要环境及控制措施** | **不涉及** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **不涉及** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **SJT10416-1993 半导体分立器件芯片总规范 国家质监总局 2012-02-25****QJ1693-1989 电子元器件防静电要求 国家质监总局 2012-04-11****QJ840-1984 电子元器件环境技术要求和试验方法 国家质监总局 2012-04-11** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **/** |
| **其它相关知识** | **/** |

**填表人(专业人员)：日期： 审核组长： 日期：**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**